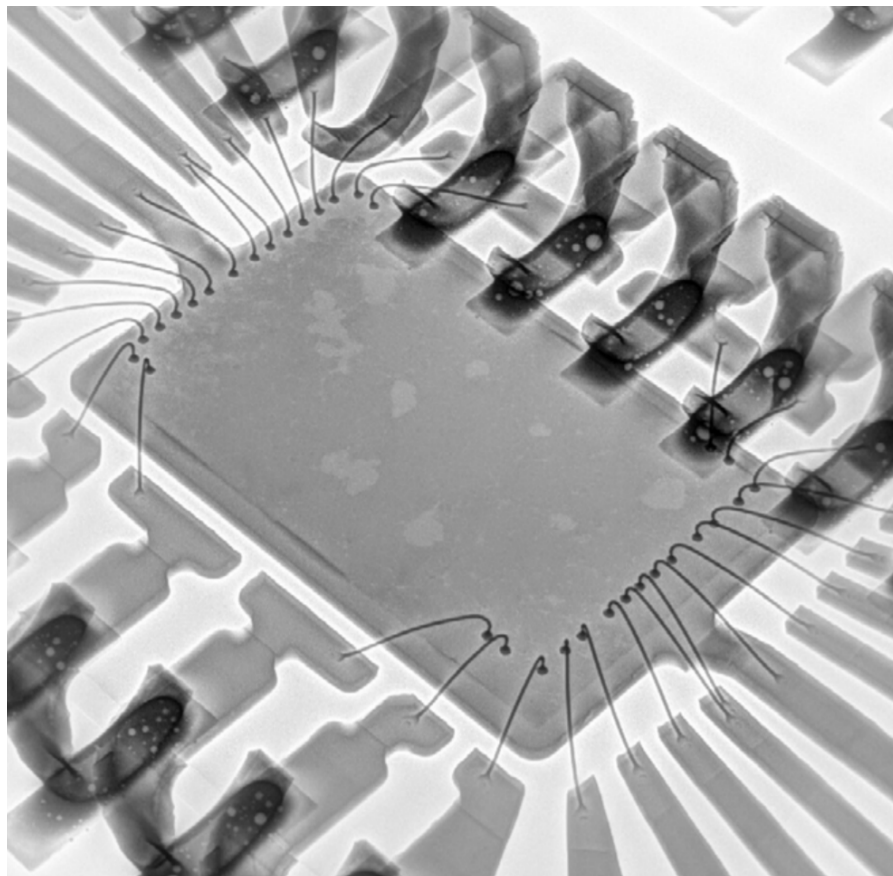


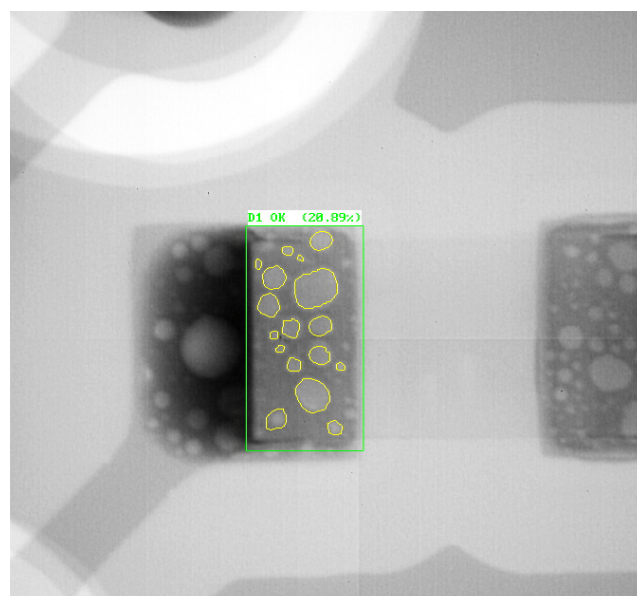
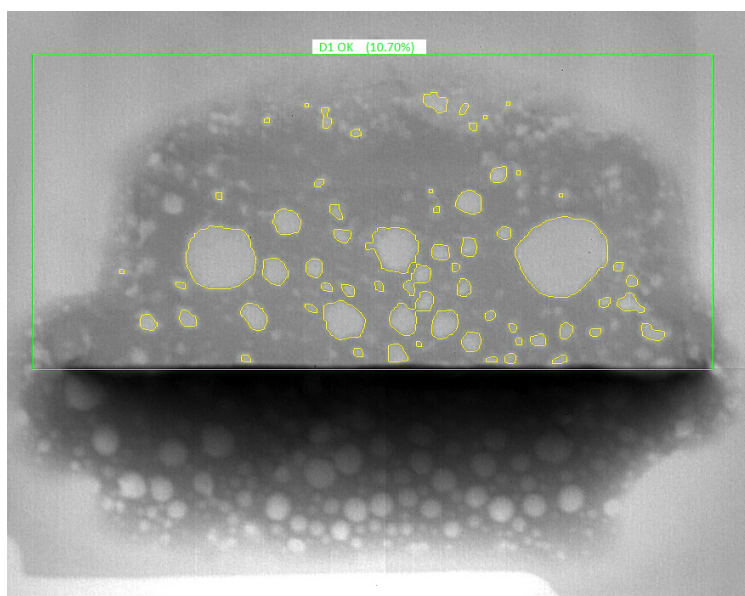
Analýza pájených spojů

Tato analýza je aplikována prostřednictvím přístroje Micromex microfocus X-ray inspection system.



Přístroj je navržen především pro inspekci složitých desek plošných spojů a SMT (Surface Mount Technology) sestav. Díky použití otevřené rentgenové trubice je dosaženo vysokého rozlišení. Vnitřní uspořádání zaručuje bezkonkurenční zvětšení s možností inspekce pájených plošných spojů či dokonce mikrotrhlin na kuličkách BGA (Ball Grid Array) pouzder. Maximální napětí trubice 180 kV umožňuje kontrolovat i desky osazené BGA pouzdry s chladiči či jinými kovovými kryty.

Pořízené rentgenové snímky jsou zpracovány unikátními nástroji s cílem zvýšení kontrastu dat a odhalení defektů. Software také umožňuje stanovit porozitu v pájených spojích. Inspekce většího množství stejných dílů lze částečně automatizovat pro účely třídění vadných dílů.



Ukázka vyhodnocení porozity pájeného spoje z rentgenového snímku. Zelenou barvou je ohraničena analyzovaná oblast. Nalezené defekty jsou znázorněny žlutou barvou. Hodnota v bílém rámečku znázorňuje procentuální výskyt defektů v analyzované oblasti.

Video ukázka [zde](#).